お客様各位

資料中の「ラピステクノロジー」等名称の
ローム株式会社への変更

2024 年4 月1 日をもって、ローム株式会社は、100%子会社である
ラピステクノロジー株式会社を吸収合併しました。従いまして、本資料中にあります
「ラピステクノロジー株式会社」、「ラピステクノ」、「ラピス」といった表記に関しましては、
全て「ローム株式会社」に読み替えて適用するものとさせていただきます。
なお、会社名、会社商標、ロゴ等以外の製品に関する内容については、変更はありません。
以上、ご理解の程よろしくお願いいたします。

２０２４年４月１日
ローム株式会社

お客様各位

資料中の「ラピスセミコンダクタ」等名称の ラピステクノロジー株式会社への変更

2020 年 10 月 1 日をもって、ラピスセミコンダクタ株式会社の LSI 事業部門は、ラピステクノロジー株式会社に分割承継されました。従いまして、本資料中にあります「ラピスセミコンダクタ株式会社」、「ラピスセミ」、「ラピス」といった表記に関しましては、全て「ラピステクノロジー株式会社」に読み替えて適用するものとさせていただきます。なお、会社名、会社商標、ロゴ等以外の製品に関する内容については、変更はありません。以上、ご理解の程よろしくお願いいたします。

2020年10月1日
ラピステクノロジー株式会社

Dear customer

LAPIS Semiconductor Co., Ltd. ("LAPIS Semiconductor"), on the 1st day of October, 2020, implemented the incorporation-type company split (shinsetsu-bunkatsu) in which LAPIS established a new company, LAPIS Technology Co., Ltd. (“LAPIS Technology”) and LAPIS Technology succeeded LAPIS Semiconductor’s LSI business.

Therefore, all references to "LAPIS Semiconductor Co., Ltd.", "LAPIS Semiconductor" and/or "LAPIS" in this document shall be replaced with "LAPIS Technology Co., Ltd."

Furthermore, there are no changes to the documents relating to our products other than the company name, the company trademark, logo, etc.

Thank you for your understanding.

LAPIS Technology Co., Ltd.
October 1, 2020

ROHM GROUP
LAPIS
SEMICONDUCTOR

18LD-0242-SpeechLSI_Errata_01J

LAPIS Semiconductor Errata

音声合成 LSI

発行日: 2018 年 3 月 5 日

ROHM
SEMICONDUCTOR

ご注意

1)本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。

2)ラピスセミコンダクタは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが，半導体製品は種々の要因で故障・誤作動する可能性があります。
万が一，本製品が故障・誤作動した場合であっても，その影響により人身事故，火災損害等が起こらないようご使用機器でのディレーティング，冗長設計，延焼防止，バックアップ，フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えたご使用や使用上の注意書が守られていない場合，いかなる責任もラピスセミコンダクタは負うものではありません。

3)本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては，本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。したがいまして，量産設計をされる場合には，外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。

4)本資料に記載されております技術情報は，本製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり，それをもって，当該技術情報に関するラピスセミコンダクタまたは第三者の知的財産権その他の権利を許諾するものではありません。したがいまして，上記技術情報の使用に起因して第三者の権利にかかわる紛争が発生した場合，ラピスセミコンダクタはその責任を負うものではありません。

5)本製品は，一般的な電子機器（AV機器，OA機器，通信機器，家電製品，アミューズメント機器など）および本資料に明示した用途への使用を意図しています。

6)本資料に掲載されております製品は，耐放射線設計はなされておりません。

7)本製品を下記のような特に高い信頼性が要求される機器等に使用される際には，ラピスセミコンダクタへ必ずご連絡の上，承諾を得てください。
・輸送機器（車載，船舶，鉄道など），幹線用通信機器，交通信号機器，防災・防犯装置，安全確保のための装置，医療機器，サーバー，太陽電池，送電システム

8)本製品を極めて高い信頼性を要求される下記のような機器等には，使用しないでください。
・航空宇宙機器，原子力制御機器，海底中継機器

9)本資料の記載に従わないために生じたいかなる事故，損害もラピスセミコンダクタはその責任を負うものではありません。

10) 本資料に記載されております情報は，正確を期すため慎重に作成したものですが，万が一，当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても，ラピスセミコンダクタはその責任を負うものではありません。

11) 本製品のご使用に際しては，RoHS 指令など適用される環境関連法令を遵守の上ご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して，ラピスセミコンダクタは一切の責任を負いません。本製品の RoHS 適合性などの詳細につきましては，セールス・オフィスまでお問合せください。

12) 本製品および本資料に記載の技術を輸出又は国外へ提供する際には，「外国為替及び外国貿易法」，「米国輸出管理規則」など適用される輸出関連法令を遵守し，それらの定めにしたがって必要な手続を行ってください。

13) 本資料の一部または全部をラピスセミコンダクタの許可なく，転載・複写することを堅くお断りします。

Copyright 2018 LAPIS Semiconductor Co., Ltd.

ラピスセミコンダクタ株式会社

〒222-8575 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-4-8
http://www.lapis-semi.com

1. はじめに

音声合成 LSI の制限事項，およびドキュメント訂正についてお知らせいたします。

1.1 一覧

項目	制限事項, ドキュメント訂正	対象商品	記載日
2.1	I2C コマンドインタフェース使用時の注意事項の追加	ML22460, ML22765/ML22764/ML22763, ML22865/ML22864/ML22863, ML22Q394	2018.02.28

2. 本通知で追加となるドキュメント訂正

2.1 I2Cコマンドインタフェース使用時の注意事項の追加

対象ドキュメント:　以下に記載の版数以前のデータシート

ドキュメント名	文書番号	項目	ページ
ML22420MB / ML22460MB データシート	FJDL22420-09	● I2C コマンドインタフェース （ML22460 適用）	P.31
ML2272X-XXX / ML2276X-XXX データシート	FJDL227XX-08	● I2C コマンドインタフェース （ML2276X に適用）	P.31
ML2282X-XXX / ML2286X-XXX データシート	FJDL228XX-11	● I2C コマンドインタフェース （ML2286X に適用）	P.32
ML22Q394　データシート	FJDL22Q394-07	● I2C コマンドインタフェース	P.24

2.1.1 訂正内容

（訂正前）
・なし
（訂正後）
・【注意】
I2C コマンドインタフェースを使用中に，本 LSI の電源を遮断した場合，I2C バスに接続されている他のデバイスの通信ができなくなります。
I2C コマンドインタフェース使用時には，本 LSI の電源は遮断しないでください。

2.1.2 改修計画

本訂正内容については，次回のデータシート改版時に修正いたします。

改版履歴

ドキュメント No.	発行日	ページ		変更内容
		改版前	改版後	
18LD-0242-SpeechLSI_Errata_01J	2018.03.05	–	–	初版発行